

光電融合半導体パッケージ技術の最新動向と今後の展望

ーデータセンタ革命を支える技術とその実装ー

セミナーURLはこちら→ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/250688>1名分料金で
2人目無料

- ◆日時: 2025年06月16日(月) 12:30~16:30
- ◆【アーカイブ配信受講: 6/17(火)~6/24(火)】を希望される方は、
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/250688A> こちらからお申し込み下さい。
- ◆【WEB限定セミナー】在宅、会社にながらセミナーを受けられます
- ◆受講料: 1名につき49,500円(税込、資料付)

会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円(税込)から
 ・1名で申込の場合、**46,200円(税込)**へ割引になります。
 ・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、**計49,500円(2人目無料)**です

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

- 講師: 国立研究開発法人産業技術総合研究所 プラットフォームフォトンクス研究センター
 総括研究主幹 博士 天野 建氏 【ご専門】光デバイス、光実装

【講演の趣旨】

生成AIの登場により、データセンタの巨大化、高性能化が近年さらに加速している。これを実現する技術として、従来のプラズマトランシーバを用いたアーキテクチャより低消費電力化が可能な半導体素子と光素子を同一パッケージ上に集積した光電融合技術が世界中で注目されている。本講演ではデータセンタの動向からなぜ光電融合技術が必要なのかを説明した後、光電融合半導体パッケージ技術の最新研究動向と我々が提案している光電融合半導体パッケージ技術に関する最新成果を講演する。

【プログラム】

- 1.光電融合半導体パッケージの背景
 - 1-1.生成AIで拡大するデータセンタ
 - 1-2.光電融合技術への期待
 - 1-3.光電融合パッケージ技術の種類とロードマップ
 - 1-4.光電融合パッケージ技術の世界的な最新研究開発動向
- 2.我々が提案する「アクティブオプティカルパッケージ」に関して
 - 2-1.概要
 - 2-2.特長
 - 2-3.要素技術1:ポリマー光導波路
 - 2-4.要素技術2:ポリマーマイクロミラー
 - 2-5.要素技術3:光コネクタ
 - 2-6.要素技術4:外部光源(ELS)を用いた動作実証
 - 2-7.アクティブオプティカルパッケージの最新成果
 - 2-8.社会実装に向けた取り組み:次世代GDC協議会光電コパッケージ検討部会

申込書	※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒< <input type="checkbox"/> LIVE / <input type="checkbox"/> アーカイブ >		
会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
 ⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
 ⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>